



产品加工指南

覆铜板：S3155G



本产品加工指南依托于 IPC-4101 标准，并在该标准的基础上，根据产品特征的实际情况进行整理，使之更利于生益 S3110 产品的使用。

1. 储存条件

1.1 覆铜板

1.1.1 存放方式

- 以原包装形式放在平台上或适宜架上，避免重压，防止存放方式不妥而引起板材形变。

1.1.2 存放环境

- 板材宜存放在通风、干燥、室温的环境下，避免阳光直射、雨淋，避免腐蚀性气体侵蚀（存放环境直接影响板材品质）；
- 双面板在合适环境下存放两年，单面板在合适环境下存放一年，其内部性能可以满足 IPC4101E 标准要求。

1.1.3 操作

- 需戴清洁手套小心操作板材。碰撞、滑动等会损伤铜箔；裸手操作会污染铜箔面，这些缺陷都可能对板材的使用造成不良影响。

2. PCB 加工建议

2.1 开料

- 推荐选用锯床开料方式，其次使用剪床，注意辊刀开料可能会引发板边分层问题。

2.2 预烘烤

- 可根据实际使用情况选择是否烘板，因存放时间较长（如开料后存放）造成的翘曲较大，采取烘烤的办法可以降低翘曲并提高耐热性。如采用开料后烘烤，建议开料后先过一遍高压水洗后再烘烤，避免剪切过程中产生的树脂粉末引入到板面，引起蚀刻不良问题；
- 建议烘板条件：110-120℃/3~5h，注意板材不能与热源直接接触。

2.3 冲型（啤板）

- 在在冲型前建议进行预烘处理，板面温度控制在 60-80℃即可，温度过高或过低都可能会影响冲型效果。
- 冲性加工时，孔径一般要求大于 1.0mm，孔壁间距大于 1.5mm，否则建议钻孔加工。

2.4 阻焊油墨

- 采用插架烘烤时，如板材插架时受到挤压或变形，烘烤后可能会容易出现翘曲问题。

2.5 喷锡

- 适用于有铅喷锡工艺。

2.6 包装

- 建议在包装前进行烘板，条件为 115-125℃/3-5h，以免潮气造成耐热性下降问题；
- 包装材料建议采用铝箔真空包装。



3. 焊接工艺

3.1 包装有效期

- 铝箔真空包装，有效期为 3 个月；
- 元件组装前最好 125°C/3~5h 烘烤后再使用。

3.2 回流焊接参数

- 适合于常规有铅回流焊接加工工艺。

3.3 手工焊接参数

对于独立焊盘或边缘焊盘

- 焊接温度 300-330°C（使用温控烙铁）。
- 单个焊点的焊接时间：3 秒以内

在使用生益 S3155G 产品期间，如有任何疑问及建议，请随时联系生益，生益将给您提供快捷有效的技术服务。